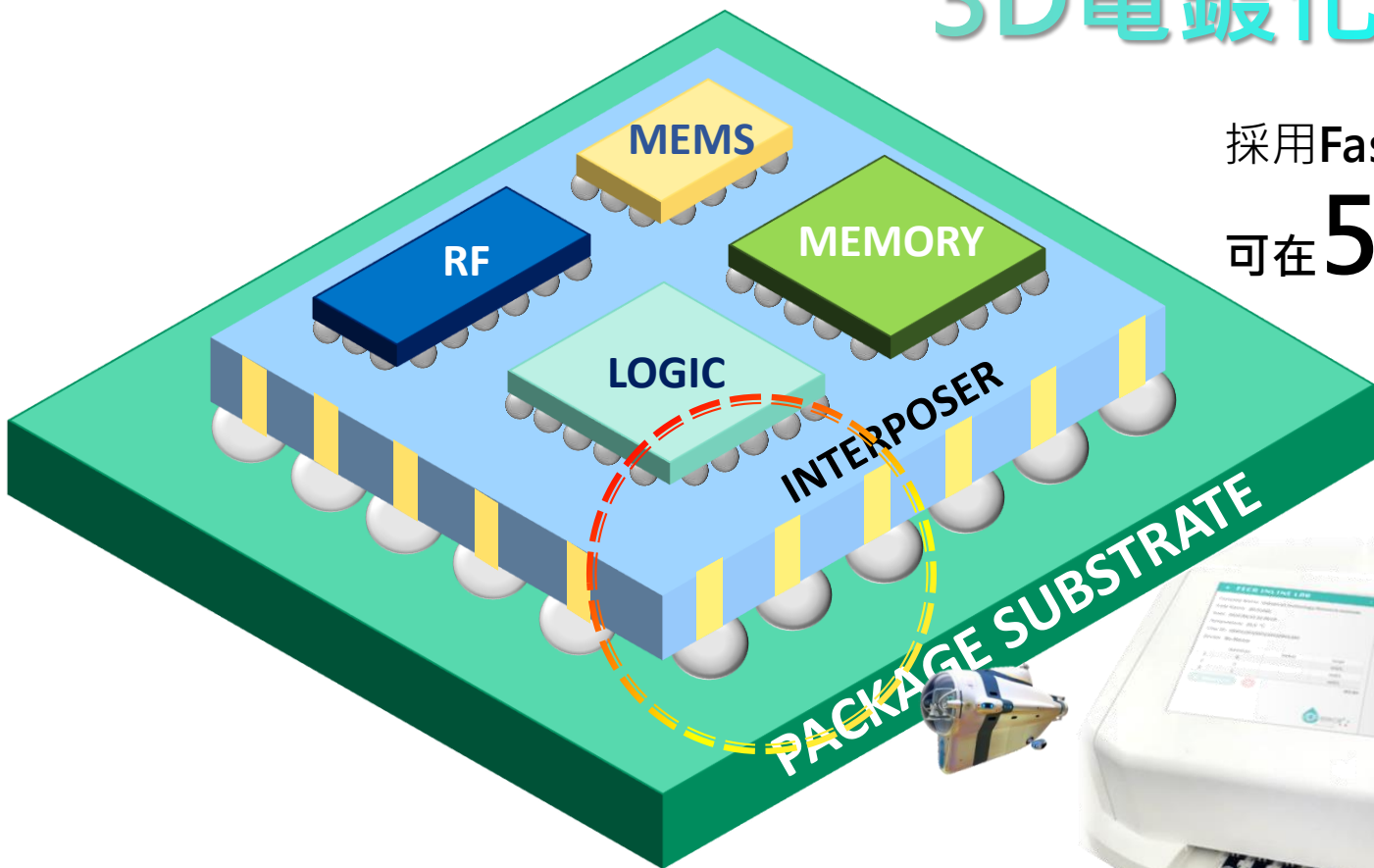


3D電鍍化學添加劑即時檢測機台

採用Fast Electrochemical Capturing Analysis(FECA)技術

可在**5分鐘**內分析3D封裝電鍍藥水所有添加劑與金屬



銅電鍍系統:
(RDL,TSV)

- ① 光澤劑
- ② 抑制劑
- ③ 平整劑
- ④ 銅離子



錫銀電鍍系統:
(Micro Bump)

- ① 加速劑
- ② 甲磺酸
- ③ 銀錯合劑
- ④ 二價錫



瑞霸生技股份有限公司

瑞霸生技

地址: 台中市南區興大路145號育成中心313室

電話: +886-4-22850766

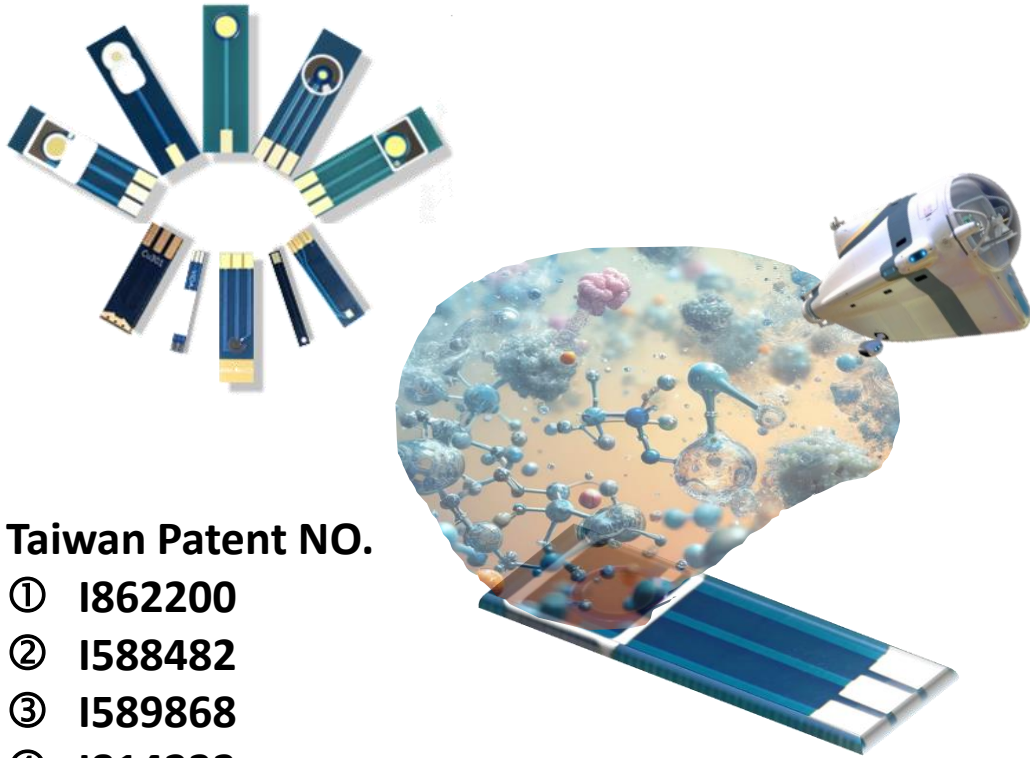
網址: www.vidabio.com.tw



Fast Electrochemical Capturing Analysis(FECA)

Nernst equation: $O + ne^- \leftrightarrow R$

Randles-Sevcik Equation: $i_p = 0.4463 nFAC \sqrt{\frac{nFvD}{RT}}$



Taiwan Patent NO.

- ① I862200
- ② I588482
- ③ I589868
- ④ I814233
- ⑤ I589870

